

项目	检测目的
光学显微镜检测	观察样品外观，表面形状、芯片裂缝、沾污、划伤、氧化层缺陷及金属层腐蚀等，测量尺寸及观察功能。
X-RAY检测	观察焊线，装片，空洞等
*超声波扫描显微镜检测	用来检测界面分层，塑封体的空洞、芯片裂缝等
JUNO测试机检测	二、三极管；数字晶体管；稳压管等半导体器件的电性测试
*半导体特性图示仪检测	二、三极管；MOS管；IC管等半导体器件的电性确认，失效管与同批次良品曲线有任何差异需要引起注意。
封装级定位（TDR）检测	TDR是通过测量反射波的电压幅度,从而计算出阻抗的变化;同时,只要测量出反射点到发射点的时间值,就可计算出传输路径中阻抗变化点的位置。主要用来失效点定位、阻抗测量、OS测试等等。

项目	检测目的
封装开封检测	LASER开封：用来减薄塑封体的厚度、保留管脚 手工开封：用湿法开帽暴露内部芯片、内引线 and 压区
芯片探针台检测	探针测试芯片，观察芯片的电参数或特性曲线
封装弹坑测试	去除焊线及压区金属层，观察压区情况
封装截面分析检测- 离子研磨系统	对样品截取适当的观察面观察焊点结合情况，分层，void等
*扫描式电子显微镜 检测	观察芯片表面金属引线的短路、开路、电迁移、氧化层的针孔和受腐蚀的情况，还可用来观察硅片的层错、位错及作为图形线条的尺寸测量等。
	EDX确认样品表面成分。
芯片去层（RIE） 检测	主要用于解决芯片多层结构下层的可观察性和可测试性。